

证券代码：300964

证券简称：本川智能

## 江苏本川智能电路科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	网上投资者（本川智能 2025 年度网上业绩说明会）
时间	2026 年 5 月 22 日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	1、董事长董晓俊先生； 2、财务负责人、董事会秘书董超先生； 3、独立董事刘红明先生； 4、东北证券股份有限公司保荐代表人王丹丹女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<b>投资者提出的问题及公司回复情况：</b> <b>1、公司在技术创新和智能制造方面取得了哪些进展？这些进展对公司的生产效率和产品质量有何影响？</b> 尊敬的投资者，您好！在技术创新方面，公司高度重视技术创新，将研发投入作为提升核心竞争力的关键抓手，持续加大研发资源投入，完善研发体系建设，强化核心技术攻坚。2025 年度，公司累计投入研发费用 0.33 亿元，同比增长 6.18%，为技术创新、新产品开发及工艺优化提供了充足保障。截至报告期末，公司技术/研发人员达 181 人，占公司员工总数的比重为 11.42%，形成了一支专业齐全、经验丰富、富有创新精神的高素质研发团队。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司累计拥有专利 73 项，其中发明专利 24 项，专利布局持续完善，构建了坚实的自

主核心技术壁垒，并形成了如“光模块产品对应 PCB 制程工艺”“印制电路板脉冲电镀生产工艺”“PTFE（聚四氟乙烯）材料加工工艺”等核心技术。同时，公司深化产学研协同创新，与高校共建研发平台，推动科研成果快速转化为实际应用产品，持续巩固技术领先优势。

在智能制造方面，公司不断提升生产制造环节的智能化、自动化、信息化、数字化、精益化管理水平。公司“年产 48 万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目”与“年产 52 万平 5G 高频高速通信电路板项目”新工厂智能化、自动化、信息化、数字化程度较高，全线规划自动化投板、自动化收板、自动导向车（AGV）运输，配合自动物流搬运、精准物流配送和管理等实现厂区多维度的智能化，使得产品全流程自动流转。同时以 MES 系统为核心，集成控制自动化、自动物流、产品追溯和自动计划系统，实现了自动化和少人化作业。公司的组织、生产、服务效率显著提升，产品可靠性和稳定性实现了全面保障和可追溯。公司整体生产经营效率得到提升，相比较传统设备组建的印制电路板工厂，产品的良率大幅提升，产品交期也大幅缩短。

## 2、公司未来的发展计划以及对未来发展前景有何看法？

尊敬的投资者，您好！2026 年度公司重点做好以下工作：

（1）产品技术研发攻坚计划：公司将紧扣产品与技术深耕战略，以“核心产品稳固、前沿产品突破”为目标，全面强化技术研发实力。

（2）智能产能升级与全球化布局计划：公司将锚定产能优化与全球化布局战略，以“智能制造升级+国内外产能协同”为核心，构建高效稳定的全球生产网络。

（3）核心客户深耕与全球市场拓展计划：公司将践行客户深耕与市场拓展战略，以“大客户深化+新市场突破”为双驱动，提升全球市场竞争力。

(4) 核心人才引育与运营效能提升计划：公司将推进人才与运营提升战略，以“人才保障+管理升级”为支撑，夯实企业发展根基。

(5) 数字化与精益运营升级计划：深化数字化与精益运营战略，立足公司现有生产运营基础，全面推动各生产基地运营效率迭代升级。

(6) 绿色生产体系构建与合规强化计划：公司将落地绿色可持续发展战略，以“合规为先、节能降耗”为核心，实现企业与环境协同发展。

(7) 投资者关系深化与价值提升计划：公司将持续立足公司实际经营需求，做好投资者关系管理与市值管理相关工作，实现企业、员工与投资者的共赢发展。

展望 2026 年，全球 PCB 行业将持续受益于 AI 算力爆发、汽车电动化智能化升级、新能源产业扩张、卫星通信与低空经济产业化等多重机遇，行业整体将保持稳步增长态势，高端产品市场需求持续旺盛，为公司主营业务发展提供广阔空间。

### **3、请问公司最近期的股东户数是多少？**

尊敬的投资者，您好！公司会在定期报告中披露对应时点的股东人数和股东信息，请及时关注公司定期报告。根据公司最新一期定期报告数据，截至 2026 年 3 月 31 日，公司股东人数为 17,237 户。

### **4、目前 PCB 行业整体情况如何？未来是否还能保持增长？**

尊敬的投资者，您好。根据 PrismaMark 数据，2025 年全球 PCB 市场产值同比增长 15.8%，达 851.52 亿美元。从中长期来看，伴随人工智能的投资和发展，进而带动了 PCB 产业的发展，全球 PCB 行业在 2025 年至 2030 年复合增长率为 7.7%，总体保持平稳增长。根据预测，未来几年，中国仍将是 PCB 行业的主要制造中心。2025 年国内 PCB 市场产值达 489.69 亿美元，同比增长 19.2%。预测 2025 年至 2030 年总体保持增长，复合增长率为

7.0%，反映了中国在 PCB 行业的核心地位。

**5、本次发行可转债的期限是多久？转股期限安排是什么？**

尊敬的投资者，您好。本次发行可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2026 年 4 月 17 日（T 日）至 2032 年 4 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日顺延期间付息款项不另计息）。本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 4 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2026 年 10 月 23 日至 2032 年 4 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

**6、公司在技术研发方面，有什么安排？**

尊敬的投资者，您好。公司将紧扣产品与技术深耕战略，以“核心产品稳固、前沿产品突破”为目标，全面强化技术研发实力。一是攻坚核心高端技术，聚焦通信设备、汽车电子、新能源三大核心领域，重点布局 6 阶 HDI 板、32 层以上高多层板、预埋板等产品的技术攻坚，筑牢现有核心产品市场根基，锚定高价值应用场景，着力提升重点应用领域 PCB 产品的市场渗透率；二是顺应人工智能、6G 通信等全球科技产业变革趋势，精准把握算力基础设施升级、新一代通信技术、低空经济发展等战略机遇，依托自身技术积累与产业优势，积极布局 6G 通信、卫星通信、光模块、AI 服务器配套产品、机器人及低空经济相关产品等前沿高成长赛道，构建“核心产品稳固、前沿产品突破”的差异化产品矩阵，进一步强化技术壁垒，为长期高质量发展筑牢根基；三是完善研发支撑体系，依托省级企业技术中心平台，深化与国内知名高校、科研机构的产学研合作，强化前沿技术储备；四是保障研发资源投入，为技术突破与量产转化提供坚实资金支撑。

未来阶段，公司的技术研发将继续坚持“以客户为中心，以

市场为导向”的经营理念，紧密结合国内外市场发展需求，积极抓住发展机遇，重点发展处于起步阶段、工艺复杂程度高、产品利润空间大的新兴产品，进一步加强公司的生产技术及研发优势。

#### **7、公司本期盈利水平如何？**

尊敬的投资者，您好。2025年，公司实现营业收入8.76亿元，同比增长46.94%，其中主营业务收入7.90亿元，同比增长43.44%，营收规模持续扩大，主要得益于高端产品销量提升及产品结构优化带来的单价增长；归属于上市公司股东的净利润0.32亿元，同比增长33.74%，盈利水平的进一步提高，体现出公司产品附加值提升、成本管控有效的核心优势；基本每股收益0.41元/股，同比增长33.69%，股东回报能力持续增强，切实保障全体股东权益。

#### **8、相较于同行业其他公司，公司的主要生产优势是什么？**

尊敬的投资者，您好。在PCB行业竞争格局分化加剧的背景下，公司精准卡位“多品种、高品质、快速交付”的高端细分赛道，深度契合电子产品研发创新阶段的定制化、快迭代核心需求，与行业内大批量标准化生产企业形成显著区隔。而相较于行业普遍水平，高端PCB产品对生产管理的精细化程度、客户需求的快速响应能力提出更高要求。

针对高端产品对订单响应能力的需求，公司将柔性制造理念贯穿生产全链条，通过优化智能化生产线布局、推行订单全流程数字化管理、实施工序模块化拆分等核心举措，自主构建了行业领先的柔性生产管理系统。依托自动化设备升级与数字化工厂建设，公司实现了生产过程的无缝衔接与高效协同，可灵活适配从单双层板到高阶HDI板、特殊基板等多类型产品的生产需求，交付效率位居行业前列。公司通过柔性化排产实现了订单交期的显著优化，常规订单交付周期可由传统的14天缩短至8天以内，

在行业内形成了鲜明的交期优势。

高效的柔性制造能力,不仅保障了公司对客户个性化需求的快速响应,更使公司在市场需求迭代时,能够以更低成本、更短周期完成产能调整与产线升级,相较于竞争对手的市场应变速度更快、调整成本更低,进一步巩固了公司在高端 PCB 市场的领先地位。

### **9、公司主要产品的核心技术有哪些?**

公司始终将技术研发作为差异化竞争的核心驱动力,紧密跟踪新兴领域的技术需求,聚焦高频高速、高阶 HDI、预埋元件、埋铜等高端 PCB 技术方向,提前布局前沿研发,构建了深厚的核心技术壁垒。

目前,公司已自主掌握多项核心技术,熟练掌握高端 PCB 产品的成熟生产工艺,并相继购置自动化、智能化、高精度的产线设备,相关技术与产品性能达到行业先进水平。2025 年,公司持续加大研发投入,重点推进高阶 HDI、预埋元件、埋铜等关键技术攻关,已形成了如高频高速 PCB 制造技术、高阶 HDI 高多层压合技术、高精密预埋元件与埋铜板工艺等核心技术,相关研发成果已进入产业化验证阶段。如在 HDI 板高多阶产品方面,技术上已实现 6 阶;在超高层数板产品方面,技术上已实现 32 层。

同时,公司积极深化产学研合作,与国内知名高校共建研发平台,推动前沿技术与产业需求精准对接,加速科研成果向实际应用转化。凭借扎实的技术积累,公司在通信设备、工业控制、汽车电子、新能源、电力等多个应用领域建立了技术优势,技术实力获得行业主管部门与头部客户的高度认可。

### **10、公司选择泰国新建生产基地的原因?**

尊敬的投资者,您好。公司海外客户较多,销售收入占比相

对较高，打造境外生产基地，可以提高海外订单响应能力；实现多元化产品供应链，加强海外客户产品交付能力；降低国际贸易争端风险影响，提高综合抗风险能力。

### **11、对于可转债募投项目，公司有哪些措施消化产能？**

尊敬的投资者，您好。对于可转债募投项目，公司通过如下措施消化产能：一是制定科学合理生产规划，明确各阶段目标与责任，加强生产管理与质量管控，优化工艺参数，提高生产效率；二是提前开展市场拓展与客户储备，与核心客户签订长期合作协议或锁定意向订单，保障新增产能有序消化；三是建立各生产基地协同调度机制，根据市场需求动态调整产能分配，提升整体产能利用率；四是持续优化产品结构，以高端高附加值产品支撑新增产能的盈利水平，降低产能爬坡期间的经营压力。

### **12、公司如何管理海外项目？**

尊敬的投资者，您好。公司具有丰富的海外市场营销经验，配置专门面向海外客户的市场营销团队，并已在美国设立专门的子公司，负责市场开拓及客户维护。公司拥有覆盖美国、欧洲等多个国家、地区的海外客户资源，上述市场资源及客户管理经验，将为“本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目”的实施提供充分的支持。此外，针对泰国生产基地，公司已经陆续招募具有相关经验的人员，组建泰国生产基地运营团队，为本次募投项目的实施做好充分的人员准备。

### **13、泰国生产基地原材料和生产设备采购来源是什么？**

尊敬的投资者，您好。以国内采购为主，随着部分上游原材料、设备中资企业在泰国开设生产基地，未来将视情况从该类企业在泰国的分支机构采购部分原材料或设备。

### **14、公司在 AI 服务器陶瓷基板方面具备什么生产能力？**

尊敬的投资者，您好。公司控股子公司皖粤光电，拥有 DBC、DPC、AMB 全系列陶瓷基板工艺，具备研发生产 AI 服务器所需

高导热氮化铝陶瓷基板的能力，现阶段主要应用于新能源汽车、光伏储能、光通信、半导体功率器件等高功率、高可靠性、高散热要求的应用场景；公司依托自有陶瓷基板技术底座，重点研发 CIPB 芯片内嵌功率基板高端方案，相比传统陶瓷基板集成度与散热性能更优，主攻 AI 服务器高功率电源、新能源汽车高压三电系统赛道，形成上游陶瓷基板配套+下游 CIPB 高端集成一体化协同布局。

**15、公司的产量、产销率以及产能利用率目前处于什么水平？**

尊敬的投资者，您好。2025 年，公司 PCB 产品产量达 123.14 万平方米、销量达 116.97 万平方米，产销率达 94.99%，产销协同高效，产能利用率维持在 89.52%的行业较高水平，规模效应持续释放，生产运营效率稳步提升，进一步摊薄单位生产成本，推动盈利水平持续改善，产能与业绩的协同发展成效显著，彰显出公司高效的生产运营能力。

**16、公司目前财务状况如何，资产负债结构与现金流表现怎样？**

尊敬的投资者，您好。公司财务状况保持稳健运行，抗风险能力与可持续发展能力持续增强，为业绩增长提供坚实保障。截至 2025 年期末，公司资产总额达 16.22 亿元，较期初增长 23.87%，资产规模稳步扩大，主要系经营积累及产能建设合理有序投入所致；负债总额 6.06 亿元，资产负债率为 37.33%，财务结构合理优化，资产负债率低于行业整体水平，偿债压力较小。同时，公司现金流状况良好，经营活动现金流净额保持正向，能够有效覆盖研发投入、产能扩张及日常经营需求，资本实力持续夯实，为公司后续技术研发、产能扩张及市场拓展提供了坚实的资金保障，也为后续业绩持续增长奠定了稳固基础，彰显出公司稳健的经营底色与较强的抗市场波动能力。

**17、公司近期在新兴产业领域有哪些合作布局？国内外产能**

	<p><b>基地建设布局推进情况如何？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好。公司通过投资入股智鼎机器人（智元机器人旗下企业）并与其开展业务合作，将产品应用领域拓展至商用清洁机器人、智能装备领域。智鼎机器人专注于商用清洁机器人的研发、生产与销售，产品主要面向商业综合体、物流园区、交通枢纽、工业厂区等场景。依托双方产业链协同优势及业务合作，公司可针对清洁机器人底盘驱动、电源管理、中央控制、伺服模组等核心部件，提供定制化 PCB 产品及解决方案，持续挖掘商用服务机器人、智能装备领域市场机会，进一步丰富公司下游应用版图。公司与智鼎机器人的业务合作订单转化规模及实际盈利贡献存在不确定性，未来发展情况敬请投资者关注公司后续在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的公告。</p> <p>目前，公司已在江苏南京、广东深圳、广东珠海布局多个核心生产基地，同时在海外设立泰国生产基地（已经开工，在建中），并在美国、中国香港等地设有多个分支机构，打造“华东+华南+海外”三大生产区域布局，形成差异化供给、可持续发展的全球化供应格局，进一步提高客户需求的响应速度，有效提升了公司的市场竞争力。</p> <p><b>18、公司境外出口销售收入情况如何？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好。2023 年度、2024 年度、2025 年度，公司境外销售收入分别为 25,025.13 万元、26,649.57 万元和 36,921.99 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 52.12%、48.39%和 46.74%。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 22 日